

论坛二十六. 超硬材料论坛

分会主席：田永君、林峰、胡晓君

单元 26-01: 10 月 9 日下午

主持人：未定

地点：S1-25

13: 30-16:00 26-01-主旨报告

主旨报告 1 (题目未定)

徐西鹏

华侨大学

主旨报告 2: 硼掺杂金刚石制备技术及其应用进展

周科朝

中南大学

主旨报告 3: 钻石提升集成电路性能

宋健民

(台湾)

主旨报告 4: 金刚石半导体器件的新进展

王宏兴

西安交通大学

主旨报告 5: 高性能金刚石同位素电池

朱嘉琦

哈尔滨工业大学

16:00-16:10 茶歇

16:10-18:10 26-02

邀请报告 1: 金刚石微波功率器件技术

冯志红

中国电子科技集团公司第十三研究所

邀请报告 2: MPCVD 法金刚石同质外延生长及 MOS 器件技术

张金凤

西安电子科技大学

邀请报告 3: 金刚石-石墨烯复合杂化薄膜的制备及其应用研究

熊鹰

西南科技大学

口头报告 1: 高质量金刚石材料制备与电子学应用

刘金龙

北京科技大学

口头报告 2: 氧化金刚石表面的结构及其性质的第一性原理研究

鲁少华

浙江工业大学

口头报告 3: 金刚石功率半导体材料与器件研究进展

李柳暗

吉林大学

口头报告 4: 金刚石功率半导体材料与器件研究进展

杨丽民

香港城市大学深圳研究院、香港大学

单元 26-02: 10 月 10 日上午

主持人：未定

地点：S1-25

08:30-10:15 26-03

邀请报告 1: 金刚石在电化学分析传感领域的研究进展

魏秋平

中南大学

邀请报告 2: 掺硼金刚石薄膜传感器的设计、制备及应用

李明吉

天津理工大学

邀请报告 3: 金刚石涂层设计与力学性能评价

黄楠

中国科学院金属研究所

口头报告 1: 硼掺杂金刚石电化学检测

高楠

吉林大学

口头报告 2: 金刚石/石墨烯复合电极电化学应用研究

蒋梅燕

浙江工业大学

口头报告 3: BDD 电极的低成本制造及应用场景

李卫

廊坊沃尔德超硬刀具有限公司

10:15-10:25 茶歇

10:25-11:50 26-04

邀请报告 1: 宽禁带半导体原子尺度制造与表征研究

徐宗伟

天津大学

邀请报告 2: 高质量一维纳米单晶金刚石构筑及性能研究

杨兵

中国科学院金属研究所

邀请报告 3: (题目未定)

缙慧阳

北京高压科学研究中心

口头报告 1: 基于金刚石 NV 色心的量子传感及其应用

张少春

中国科学技术大学

口头报告 2: 金刚石中硅空位色心构建及性能调控

陈成克

浙江工业大学

单元 26-03: 10 月 10 日下午

14:00-15:40 26-5

邀请报告 1: 超硬材料与刀具制造及其应用

郑李娟

广东工业大学

邀请报告 2: 基于热管传热原理的磨削高效冷却技术研究进展

钱宁

南京航空航天大学

口头报告 1: 柔性复合磨料制备及其力流变抛光性能

王金虎

浙江工业大学

口头报告 2: 基于金刚石单颗粒划擦的硬脆材料去除机制研究进展

隋天一

天津大学

口头报告 3: 脆性材料高效超精密加工

黄水泉

燕山大学

口头报告 4: 金刚石线锯切割晶圆表面线痕形成机制及调控研究

廖信江

华侨大学

15:40-15:50 茶歇

15:50-17:50 26-6

沙龙 1: 金刚石的功能化应用前景与趋势

沙龙 2: 培育钻石的发展趋势及技术需求

。 。 。 。 。 。